

OPUS 3

自动化晶圆探针平台

OPUS 3 提供半导体业界高精度与最佳效率及可靠温度控制的自动化晶圆探针平台，适用6、8、12寸的晶圆测试。



产品特点

功能	优势	效益
具有快速PMI检测功能	大可视范围可容纳多个PMI功能执行	针测结果自动化判断，节省人力时间
专利Z型平台结构	提供业界最大检测力	增加生产效率
相机扫描晶舟盒内芯片位置	当错误发生，机台报警设备会自动储存影像，方便工程师分析数值排除错误	利用实际影像的像素差异数值，可以计算芯片位置的偏差量，提供好的薄或翘曲晶圆取片方案
高精度定位与载台移动快速	提供高效率与一致性的针测结果	减少重测时间与人员判断次数
密实的结构设计	空间小，节省占地空间	增加生产效率
兼容于他厂探针台设定档案格式	易于测试平台转换与可离线编辑针测程序	节省时间与利用率最大化

产品规格

名称	OPUS 3
适用晶圆尺寸与种类	尺寸：6、8、12寸 种类：未切割与切割后晶圆
X,Y针测范围	X：±175mm
	Y：±165mm
最大检测力	可达500公斤（视机型）
X/Y轴精准度	X轴：+/- 1.5μm
	Y轴：+/- 1.5μm
温度选项	中高温：室温~150°C 低温：-40°C~150°C / -55°C~200°C

Contact us

